

方正证券承销保荐有限责任公司
关于甬矽电子(宁波)股份有限公司
2023 年半年度持续督导跟踪报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关法律、法规的规定，方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为甬矽电子(宁波)股份有限公司（以下简称“甬矽电子”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，负责甬矽电子上市后的持续督导工作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与甬矽电子签订《持续督导协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务
3	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2023 年上半年度甬矽电子在持续督导期间未发生按有关规定需保荐机构公开发表声明的违法违规情况
4	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当自发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	2023 年上半年度甬矽电子在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项
5	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、尽职调查等方式，了解甬矽电子经营情况，对甬矽电子开展持续督导工作
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	在持续督导期间，保荐机构督导甬矽电子及其董事、监事、高级管理人员遵守法律法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及

序号	工作内容	持续督导情况
		其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促甬矽电子依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对甬矽电子的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，甬矽电子的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促甬矽电子严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对甬矽电子的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	2023 年上半年度，甬矽电子及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	2023 年上半年度，甬矽电子及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	2023 年上半年度，甬矽电子不存在应及时向上海证券交易所报告的情况

序号	工作内容	持续督导情况
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2023 年上半年度，甬矽电子未发生相关情形
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量。	保荐机构已制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求。
16	上市公司出现下列情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起 15 日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项	2023 年上半年度，甬矽电子不存在需要专项现场检查的情形

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

（一）业绩大幅下滑或亏损风险

报告期内，受外部经济环境及行业周期波动影响，全球终端市场需求依旧较为疲软，下游需求复苏不及预期，公司所处的封测环节亦受到一定影响。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）发布的预测称，2023 年全球半导体市场规模将同比减少 10.3%，降至 5150 亿美元；预计 2024 年半导体市场规模将比 2023 年增加 11.8%，达到 5759 亿美元，并高于 2022 年 5740 亿美元的市场规模。作为专注于中高端先进封测领域的封测企业，公司努力克服整体行业下行的不利影响，持续关注客户需求，围绕客户提供全方位服务，通过增强新客户拓展力度、加强新产品导入力度、提升产品品质、缩短供货周期、降低产品成本等多种方式，提升客户满意度和自身竞争力，2023 年上半年特别是二季度，公司稼动率整体呈稳定回升趋势。2023 年二季度，公司实现营业收入 55,806.80 万元，同比增长

0.55%，环比增长 31.42%；但由于下游客户整体订单仍较为疲软，部分产品线订单价格承压，导致公司上半年整体毛利率较去年同期仍有所下降；同时，公司二期项目建设有序推进，公司人员规模持续扩大，人员支出及二期筹建费用增加，使得管理费用同比增长 84.94%；综合导致公司 2023 年上半年出现亏损，归属于上市公司股东的净利润为-7,889.89 万元，同比下滑 168.62%。公司将积极采取新客户开发、拓展新产品线等方式提升自身竞争力和盈利能力，但若未来半导体产业持续低迷或公司投资项目产能爬坡不及预期，公司业绩可能出现持续下滑甚至亏损的风险。

（二）核心竞争力风险

集成电路市场的快速发展和电子产品的频繁更新换代，使得公司必须不断加快技术研发和新产品开发步伐，如果公司技术研发能力和开发的新产品不能够满足市场和客户的需求，公司将面临技术研发和新产品开发失败的风险。

针对上述风险，公司未来将紧跟半导体行业技术发展趋势，及时了解和深入分析市场发展和客户需求的变化，加大集成电路先进封装技术的研发和产业化，分散和化解市场及研发风险。

（三）经营风险

1、原材料价格波动的风险

公司主要原材料包括基板、引线框架、镀钯铜丝、塑封树脂、导电胶等。公司原材料价格受市场供求变化、宏观经济形势波动等因素的影响，若未来公司原材料价格出现大幅波动，而公司产品售价不能及时调整，将给公司的盈利能力造成不利影响。

2、客户集中度较高的风险

报告期内，公司前五大客户的营业收入占公司营业收入的比例为 37.11%，客户集中度相对较高。若未来公司与下游主要客户合作出现不利变化，或原有客户因市场竞争加剧、宏观经济波动以及自身产品等原因导致市场份额下降，且公司未能及时拓展新客户，则公司将会存在收入增速放缓甚至下降的风险。

（四）财务风险

1、存货跌价风险

公司封装所需要的原材料品类较多，且基板、专用引线框架等主要原材料交付周期受市场供需关系影响波动较大。公司为了应对原材料供应的波动性，通常会根据客户订单预测情况备有一定量的安全库存。2020年至2023年6月30日，公司存货账面价值分别为9,376.12万元、27,887.65万元、32,057.30万元和30,321.42万元，占流动资产的比例分别为18.04%、28.36%、17.96%和13.85%，主要由原材料和在产品组成。针对存货中原材料余额较高的情况，公司会通过生产计划和供应链管理促使原材料库存保持合理水平。若市场环境发生重大变化，公司未能及时调整库存水平，则可能出现存货跌价的风险。

2、毛利率波动风险

公司主营业务毛利率存在较大波动。公司产品毛利率同产能利用率、主要原材料价格波动、市场供需关系等经营层面变化直接相关。同时，由于公司封装产品型号众多，不同型号产品在生产加工工艺和所需原材料构成均存在一定差异，因此产品结构变化也会对公司主营业务毛利产生较大影响。若未来上述因素发生不利变化，比如产能利用率下降、主要原材料价格大幅上涨或市场需求萎缩导致产品价格下降等，则公司主营业务毛利率可能出现下降的风险。

（五）行业风险

1、市场竞争风险

近年来，随着我国集成电路封测行业快速发展，吸引了众多的企业进入，同时智能手机、PC等消费类电子市场需求疲软，市场处于去库存阶段，公司未来业务发展将面临一定的市场竞争加剧的风险，市场竞争的加剧，可能导致行业平均利润率下降，进而对公司销售额及利润率造成一定影响。对此，公司将持续加大研发投入，加强市场开拓，强化降本增效，提高产品价格竞争力，积极应对市场竞争。

2、行业波动及需求变化风险

公司主营业务为半导体行业集成电路封装测试，集成电路行业的发展状况对

公司的生产经营具有重大直接影响。集成电路行业具有与宏观经济同步的特征，其波动幅度甚至会超过全球经济波动幅度。若未来宏观经济形势变化，全球集成电路产业市场出现较大波动，将对公司经营业务和经营业绩带来较大的影响。

（六）宏观环境风险

1、全球经济波动的风险

目前全球经济仍处于周期性波动当中，尚未出现经济全面复苏的趋势，依然面临下滑的可能，全球经济放缓可能对半导体行业带来一定的不利影响，进而间接影响公司的业绩。未来，若国内和国外经济若持续低迷，可能导致消费者消费预期降低，进而持续影响半导体行业，对公司生产经营产生不利的影响。

2、产业政策变化风险

政府对集成电路行业的产业政策为我国集成电路封装测试企业提供了良好的政策环境，若国家产业政策发生不利变化，将对行业产生一定的影响。公司将持续关注市场动向、宏观经济形势、相关政策、客户需求等变化，并建立对标体系，及时调整经营发展目标和投资方向，降低相关市场风险带来的影响。

四、重大违规事项

2023 年上半年度，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2023 年上半年度，公司主要财务指标及数据如下：

（一）主要会计数据

单位：元

主要会计数据	本报告期 (2023年1-6月)	上年同期 (2022年1-6月)	本期比上年同期 增减 (%)
营业收入	982,713,424.55	1,135,585,337.21	-13.46
归属于上市公司股东的净利润	-78,898,883.99	114,977,910.53	-168.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-113,759,544.25	94,195,246.59	-220.77
经营活动产生的现金流量净额	252,599,106.59	404,461,804.49	-37.55
主要会计数据	本报告期末 (2023.6.30)	上年度末 (2022.12.31)	本期末比上年度 末增减 (%)

归属于上市公司股东的净资产	2,438,810,393.96	2,553,847,009.77	-4.50
总资产	10,172,298,147.81	8,318,700,069.06	22.28

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (2023年1-6月)	上年同期 (2022年1-6月)	本期比上年同期增 减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.19	0.33	-157.57
稀释每股收益(元/股)	-0.19	0.33	-157.57
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股)	-0.28	0.27	-203.70
加权平均净资产收益率(%)	-3.14	8.02	减少 11.16 个百分点
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%)	-4.53	6.57	减少 11.10 个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	6.27	5.30	增加 0.97 个百分点

2023 年上半年度，公司主要财务数据及指标变动的的原因如下：

归属于上市公司股东的净利润变动主要系本报告期下游需求相对低迷导致营收规模整体下滑，订单价格疲软叠加一季度稼动率不饱和导致毛利下降，二期项目筹建引起管理费用增加，以及汇率波动汇兑损失导致财务费用净损失增加等原因，导致利润减少所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动与本报告期内归属于上市公司股东的净利润减少原因基本一致。

经营活动产生的现金流量净额变动主要系本报告期收入减少，以及公司规模扩大引起的职工薪酬及其他经营性费用增加所致。

基本每股收益及稀释每股收益变动原因为主要系本报告期内归属于上市公司股东的净利润减少所致。

扣除非经常性损益后的基本每股收益变动原因为主要系本报告期内归属于上市公司股东的净利润减少所致。

六、核心竞争力的变化情况

1、客户资源优势

凭借稳定的封测良率、灵活的封装设计实现性、不断提升的量产能力和交付及时性，公司获得了集成电路设计企业的广泛认可，并同众多国内外知名设计公

司缔结良好的合作关系。报告期内，公司围绕客户提供全方位服务，通过增强新客户拓展力度、加强新产品导入力度、提升产品品质、缩短供货周期、降低产品成本等多种方式，提升客户满意度，公司客户结构持续优化，与多家细分领域头部客户建立战略合作伙伴关系，并获得多家客户颁发的战略合作供应商、最佳合作供应商、优秀战略合作伙伴等荣誉。

2、技术及产品结构优势

公司系国家高新技术企业，公司 2020 年入选国家第四批“集成电路重大项目企业名单”。公司具备较强的技术研发能力，截至 2023 年 6 月 30 日，公司总计取得了 111 项发明专利授权、162 项实用新型专利授权、2 项外观设计专利以及 6 项软件著作权，在高密度细间距凸点倒装产品（FC 类产品）、系统级封装产品、4G/5G 射频功放封装技术、高密度大尺寸框架封装产品、MEMS 封装产品、IC 测试等领域均拥有核心技术。公司“年产 25 亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目”被评为浙江省重大项目。

公司从成立之初即聚焦集成电路封测业务中的先进封装领域，车间洁净等级、生产设备、产线布局、工艺路线、技术研发、业务团队、客户导入均以先进封装业务为导向，业务起点较高。因此与同行业竞争者相比，甬矽电子产品结构较为优化，销售收入主要来自于中高端封装产品，并在射频前端芯片封测、AP 类 SoC 芯片封测、触控 IC 芯片封测、WiFi 芯片封测、蓝牙芯片封测、MCU 等物联网（IoT）芯片封测等新兴应用领域具有良好的市场口碑和品牌知名度。

3、人才优势

公司拥有完整高效的研发团队，并重视研发队伍的建设和培养，研发团队核心人员均具备丰富的集成电路封装测试行业技术开发经验。公司拥有专业的工程技术和生产管理团队，可以根据客户提出的各种封装测试要求及时做出响应，并根据市场需求对产品种类和产量进行快速调整。截至 2023 年 6 月 30 日，公司拥有研发技术人员 614 人，占公司总人数的比例 14.79%。

2023 年上半年度，公司的核心竞争力未发生不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

(一) 研发支出情况

公司坚持自主创新，持续进行研发投入。2023 年上半年度，公司研发支出情况如下：

单位：元

项目	本期	上年同期	变化幅度 (%)
费用化研发投入	61,602,435.44	60,211,229.84	2.31
资本化研发投入	0	0	0
研发投入合计	61,602,435.44	60,211,229.84	2.31
研发投入总额占营业收入比例 (%)	6.27	5.3	增加 0.97 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	不适用	不适用	不适用

(二) 研发进展

1、在研项目情况

单位：元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	工艺能力提升研究类项目 (如 Hybridsp 产品、滤波器产品等)	115,140,000.00	21,365,637.52	52,884,528.18	高密度 QFP 封装能力建立/装片盖印点胶技术研究/超高散热 FC 封装工艺开发/FC 封装 bump 虚焊研究 /C-MOLDFC 产品技术开发/多芯片复杂线弧产品焊线能力研究/SMT 高密度制程能力建立/划片 chipping 优化	提升芯片封装工艺技术能力	行业先进	技术逐步应用在消费电子产品, 以及向高可靠性/高质量要求的工规和车电产品应用推广

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
					方案开发/C-MOLD 超薄产品能力开发/单颗电镀工艺能力开发/工艺能力研究等方面，由消费类电子拓展到工规及车规产品应用			
2	设计仿真技术研究类项目(如 Delphi 热阻等研究等)	2,170,000.00	895,166.81	895,166.81	完成材料导热率对封装散热、热阻模型仿真效率提升等研究，及输出相应的指导规则并进行新产品设计应用	提升前沿封装芯片设计仿真能力	行业先进	对应在高算力芯片及高密度集成模组产品方向的建模仿真技术研发，已部分应用在新产品开发
3	生产工艺效率提升研究类项目(如中央供酸、快速印字检测等)	29,580,000.00	8,790,095.26	24,036,412.90	完成对同片 Wafer 同时多次装片技术能力研究/标签二维码比对系统/BinCode 系统开发/客户特殊程序系统化管理/自动化生产天车系统/高 Tg 塑封料多层叠芯片铜线产品开帽技术开发/砷化镓芯片开帽及弹坑技术开发/快速印	提升生产效率及自动化建设	行业先进	推进封装生产线自动/高效化管理，提升生产效率同时提升产品品质

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
					字检测工艺开发/自动化生产-中央供酸导入开发/等开发及推进在线生产应用			
4	新材料应用开发类项目(如国厂基板应用研究等)	12,520,000.00	3,340,643.16	10,202,703.33	完成对砷化镓等特殊材质芯片分析技术/BGA 高散热盖技术应用/ets 基板设计研究/coreless 国产化材料应用研究,并在对应存在挑战项目上推进应用	建立新材料技术储备及应用	行业先进	结合封装产品结构/应用调整,及材料供应链策略,匹配需求新特性材料应用开发
5	新封装产品开发类项目(如堆叠封装、单颗散热封装技术开发等)	27,020,000.00	11,062,320.13	26,590,472.86	完成对封装芯片电磁屏蔽技术/先进传感器芯片封装工艺/双面封装技术/堆叠封装技术/超薄基板FC 作业技术/LQFP 封装技术/POP 模组项目工艺技术等研发,并逐步在 5G 通讯及车规芯片实现应用	提升新产品研发能力及技术竞争力	行业先进	新产品研发覆盖消费电子/车电/IOT 等多领域,扩宽产品线及提升在高端封测上的技术竞争力
6	新工艺能力研发类项目(如晶圆级封装)	17,080,000.00	7,606,665.87	12,138,060.01	提前布局进行凸块及重布线技术/TSV/膜状底	提升新工艺开发能	行业先进	晶圆级封装技术作为 Flipchip 的前制程

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
	装技术系统研究等				填热压键合技术/不同结构微凸点制造技术/扇入及扇出技术等研究，并在接下来的研发及生产过程中逐步推进量产；同步完成高密度多圈引脚及高焊接性能 QFN 技术/不同工艺基板倒装工艺能力提升等技术研究，并实现量产产品应用	力及技术竞争力		及向先进小芯片 (Chiplets) 技术发展，已广泛应用于消费电子/工控/通讯/大基建/物联网等各行各业，前景广阔
合计	/	203,510,000.00	53,060,528.75	126,747,344.09	/	/	/	/

2、报告期内研发成果

2023 年上半年度，公司新增申请发明专利 18 项，实用新型专利 28 项，软件著作权 3 项；新增获得授权的发明专利 8 项，实用新型专利 42 项，软件著作权 3 项。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况是否合规

根据中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子（宁波）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2286 号），同意公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 6,000.00 万股，发行价格为 18.54 元/股，募

集资金总额为 111,240.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 10,332.10 万元后，实际募集资金净额为人民币 100,907.90 万元。上述募集资金已全部到账并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 11 月 11 日出具了《验资报告》（天健验[2022]608 号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用及结余情况具体如下：

单位：元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	1,009,078,959.63
截至期初累计发生额	项目投入	B1	784,008,538.42
	利息收入净额	B2	862,313.87
本期发生额	项目投入	C1	224,476,889.48
	利息收入净额	C2	1,176,434.04
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	1,008,485,427.90
	利息收入净额	D2=B2+C2	2,038,747.91
应结余募集资金		E=A-D1+D2	2,632,279.64
实际结余募集资金		F	2,884,612.46
差异[注]		G=E-F	-252,332.82

注：实际结余募集资金 2,884,612.46 元与应结余募集资金 2,632,279.64 元差异 252,332.82 元，系公司自有资金垫付募集资金股权应支付的印花税导致。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
交通银行股份有限公司宁波余姚泗门支行	307006227013000113260	2,884,612.46	活期
中国银行股份有限公司余姚分行	387081898936	0	活期
中国建设银行股份有限公司宁波市分行	33150199523600001604	0	活期
中国农业银行股份有限公司余姚分行	39633001040010780	0	活期
合计		2,884,612.46	

公司 2023 年上半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时

履行了相关信息披露义务，募集资金的使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司控股股东为浙江甬顺芯电子有限公司，持有公司 74,210,000 股股份，持股比例为 18.20%。2023 年上半年度，公司控股股东持股数量未发生变化，不存在质押、冻结或减持情况。

2023 年 5 月 25 日，公司副总经理李大林获授限制性股票 70 万股。

除上述限制性股票授予情况外，截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化，不存在质押、冻结或减持情况。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

(此页无正文，为《方正证券承销保荐有限责任公司关于甬矽电子(宁波)股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人：


曹方义


李广辉

方正证券承销保荐有限责任公司

